

Presseinformation

Neues ThinPAK 5x6-Gehäuse bringt die kleinsten CoolMOS™ MOSFETs aller Zeiten in Adapter, Unterhaltungselektronik und Beleuchtungsanwendungen

Neubiberg – 15. Mai 2014 – Infineon Technologies stellt heute mit dem ThinPAK 5x6 ein neues SMD (Surface Mounted Device)-Gehäuse für seine CoolMOS™ MOSFETs vor.

Ladegeräte für mobile Endgeräte, moderne HD-TV-Geräte oder auch LED-Beleuchtungen müssen zahlreichen, teils widersprüchlichen Anforderungen gerecht werden. Nutzer verlangen kleine und trotzdem leistungsstarke Produkte. Systemhersteller müssen daher auf kompakte, energie- und kosteneffiziente Halbleiter-Lösungen zurückgreifen. Die anspruchsvollen Größenvorgaben können nur erfüllt werden, wenn die Abmessungen und das Gewicht der einzelnen Komponenten auf der Leiterplatte reduziert werden.

Allein für den weltweiten Smartphone-Markt erwartet das Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics (2014) ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,4 Prozent (2013 bis 2018).

Bei den Ladegeräten zeigt sich ein klarer Trend: kleiner, schneller, sparsamer. Mit einer Bauhöhe von nur 1 mm, bei einer Grundfläche von 5 mm x 6 mm beansprucht das ThinPAK 5x 6 ein um 80 Prozent kleineres Volumen im Vergleich zu herkömmlichen SMD-Gehäusen wie beispielsweise DPAK. Hersteller gewinnen damit Flexibilität beim Design von noch kompakteren Ladegeräten. Die sehr geringen parasitären Effekte des ThinPAK – wie z.B. eine geringere Source-Induktivität im Vergleich zu einem gängigen DPAK-Gehäuse – reduziert die Gate-Oszillation unter allen Last-Bedingungen. Außerdem wird das Überschwingen der Spannung während des Schaltens im Vergleich zu Standard-SMD-Gehäusen um 40 Prozent verringert. Beides führt zu einer Verbesserung der Chip- und der System-Stabilität und erleichtert die Anwendung.

Mit dem ThinPAK 5x6 erhalten Entwickler mehr Flexibilität für ihre Leiterplatten-Designs und ein besseres Schaltverhalten. Das resultiert in einer effizienteren

Leistungsumsetzung und Reduzierung der Systemgröße in Anwendungen wie Leistungs-Adaptern, Beleuchtungen oder Thin-Panel-TV-Geräten. Das neue Gehäuse folgt dem ThinPAK 8x8, das sich mittlerweile sehr erfolgreich in Hochleistungs-Anwendungen wie Server- oder Telekom-Schaltnetzteilen etabliert hat.

Verfügbarkeit

Entwicklungsmuster des ThinPAK 5x6-Gehäuses sind verfügbar, während die Serienfertigung im September 2014 beginnt. Weitere Informationen zum neuen ThinPAK 5x6-Gehäuse von Infineon gibt es unter www.infineon.com/ThinPAK5x6.

Infineon auf der PCIM 2014

Infineon präsentiert das ThinPAK 5x6-Gehäuse vom 20. bis zum 22. Mai 2014 auf der Fachmesse PCIM in Nürnberg in Halle 9 auf Stand 311. Weitere Informationen zu den Messehighlights sind verfügbar unter www.infineon.com/PCIM2014.

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.